

2023年度 製造中核人材育成セミナー日程

	1日目(火)	(プロセス)	2日目(水)	(プロセス)	3日目(木)	(プロセス)	4日目(金)	(プロセス)
9:00			プロセス講義(安藤)		プロセス講義(安藤)		プロセス講義(安藤)	
				37. p-ch S/Dフォトリソ (城戸)				52. 配線フォトリソ (城戸)
			実習生プロセス(佐藤) ・フォトリソ(2回目)		休憩	43. RCA洗浄 (城戸)		
10:00					装置説明(CR)(佐藤) ・RCA洗浄			
			装置説明(佐藤) ・イオン注入装置 実習生プロセス(佐藤) ・イオン注入	38. p-ch S/Dインブラ (城戸)	実習生プロセス ・RCA洗浄(佐藤) ・拡散炉(佐藤) ・PE-CVD(佐藤)		実習生プロセス	53. AIエッチング (城戸)
	開始 10:30 御挨拶(中村センター長)					44. S/D活性化熱処理 (城戸)	・フォトリソ(4回目)(佐藤) ・MetalRIE工程(佐藤) ・レジスト除去(WET)(佐藤) ・Aシンタリング(佐藤)	54. フォトレジスト除去 (城戸)
11:00	オリエンテーション(馬場)	予備時間						
	安全教育(馬場)		デバイス講義(馬場)	39. フォトレジスト除去 (城戸)	プロセス講義(安藤)	45. 酸化膜堆積 (城戸)		55. シンタリング (城戸)
	クリーンルーム入室・見学 (安藤・佐藤)							
12:00	昼食 Lunch	予備時間	昼食 Lunch	予備時間	昼食 Lunch	予備時間	昼食 Lunch	測定 (安藤)
13:00	進捗状況説明・プロセス講義(安藤)			40. n-ch S/Dフォトリソ (城戸)	実習生プロセス(佐藤) ・PE-CVD ・フォトリソ(3回目) ・エッチング(2回目)	46. コンタクトフォトリソ (城戸)	13 周辺装置実習 ・ダイサー(佐藤) ・ワイヤーボンディング(佐藤)	・ウエハダイシング ダイシング(城戸)
			設計講義(中村)				測定実習説明(安藤) ・測定デバイス、結果予測など	・測定(安藤)
14:00	装置説明(CR)(佐藤) ・フォトリソグラフィ 実習生プロセス(佐藤) ・フォトリソ(1回目)	34. ゲートフォトリソ (城戸)	14 個別装置実習(佐藤) ・マスクレス露光装置		装置説明(CR)(佐藤) ・スパッタリング	47. 酸化膜エッチング(RIE) 48. 酸化膜エッチング 49. フォトレジスト除去 (城戸)	14 休憩	
			CRユーティリティ見学(佐藤)	41. n-ch S/Dインブラ (城戸)	実習生プロセス(佐藤) ・スパッタリング工程		測定実習(安藤) ・p-MOS、n-MOS、リングオシレー タなど測定	・譲渡CD-ROM作成 (城戸)
15:00	休憩		休憩		15 休憩			
	プロセス講義(安藤)	35. Poly-Siエッチング 36. フォトレジスト除去 (城戸)	館内・館外ユーティリティ見学 (安藤)		CMOS周辺装置実習: FIB-SEM(佐藤) ・FIB-SEMの紹介 ・既存CMOSチップの観察、FIB加工	50. HF洗浄 51. Al堆積 (城戸)	まとめ(中村センター長) 修了証授与 終了16:00	
16:00	装置説明(CR)(佐藤) ・RIE装置 実習生プロセス(佐藤) ・エッチング ・フォトレジスト除去			42. フォトレジスト除去 (城戸)				
			プロセス講義(安藤)		プロセス講義(安藤)			
17:00	Q&A(自由参加:馬場・安藤)	予備時間	Q&A(自由参加:馬場・安藤)	予備時間	Q&A(自由参加:馬場・安藤)	予備時間		

座学など(講義室)
実習・見学(CR、センター内施設)
昼食・休憩

注意: セミナーの進捗状況によりスケジュールが変更になる場合がございます。